

エレクトロニクス

ファイナルフィニッシュ

ORMECON

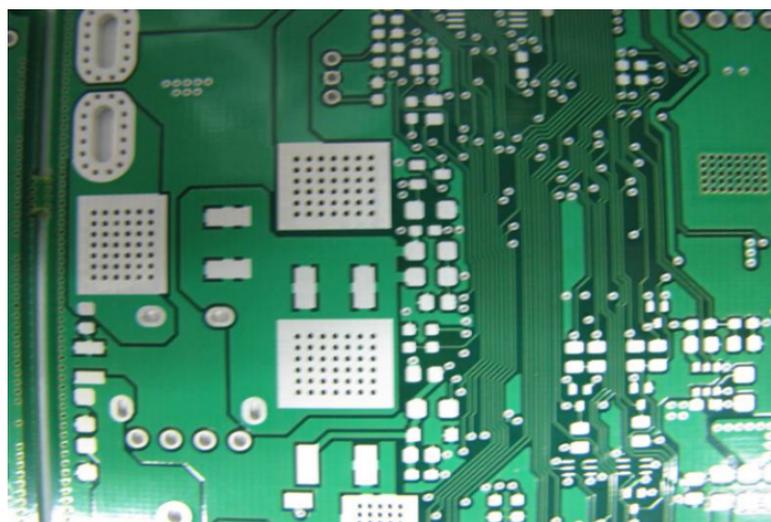
ORMECON®CSN Classicは、非常に安定した置換スズめっきプロセスです。特許取得済みのOrganicMetal®プレディップ (OM) は、NanoMetal層を形成し、スズめっき—銅間の拡散速度を65%も低減します。

そしてこのプレディップ処理で形成されたNanoMetal層は、スズの析出時の触媒としても働き、スズは大きな結晶粒子となります。

またウィスカー抑制効果のあるプレディップ (OM-Ag) を使用すると、ウィスカーの成長を大きく抑えることが可能です。

特徴

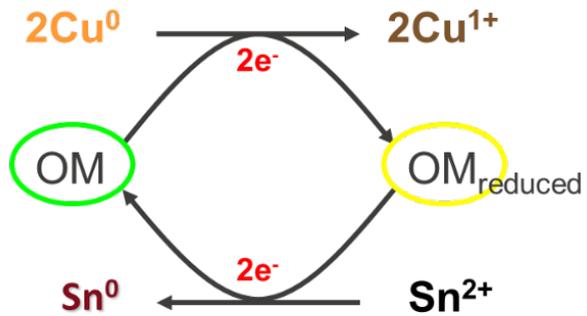
- 特許取得済みのOrganicMetal®プレディップ
- 大きな結晶構造のスズめっき皮膜
- スズ — 銅間の拡散速度の低減
- ウィスカー発生の抑制
- シェルライフの長期化
- 優れたはんだ付け特性
- 鉛フリーはんだでの複数回リフローを許容



ORMECON[®] CSN Classic

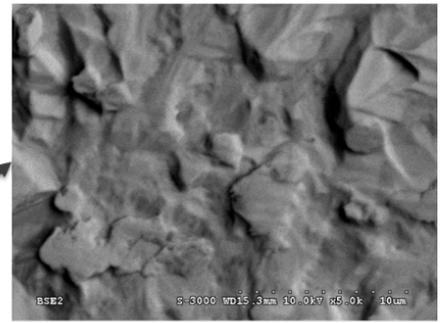
スズ析出反応

触媒：オーガニックメタル (OM : Organic Metal)



銅は Cu^{1+} のみが反応に関与

OMを用いた置換スズ



OM-Agを用いた置換スズ

